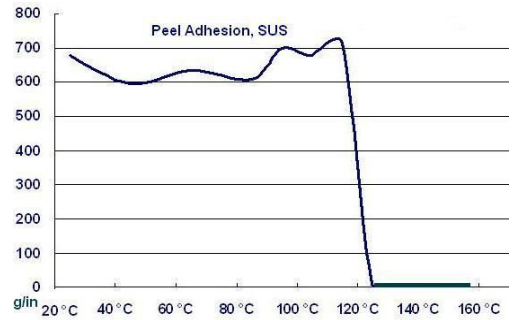
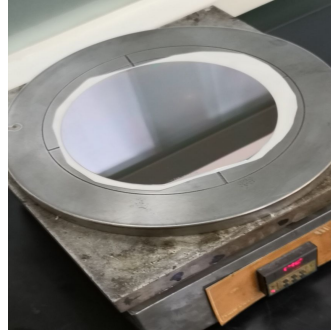
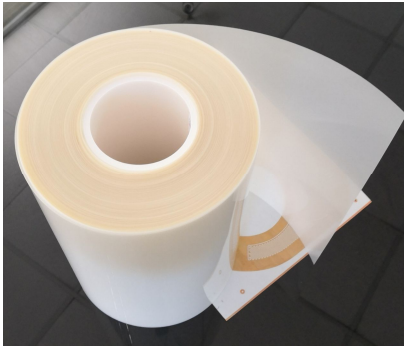


# 熱解膠膜 Thermal Off Tape



**全科熱解膠膜**是一種特製之黏性膠帶，在工作完成後加熱至適當溫度就可自動脫離。專為積層陶瓷電容(MLCC)之堆疊、切割、翻轉，以及各類晶片切割、研磨、翻轉之用。尤其是在一般之UV解黏膠帶無法達成的工作，經常可藉由熱解膠膜來完成。

也可雙面背膠，以方便固定。

全系列產品符合 RoHS 2.0 及 REACH 要求。

## 產品分類

厚度↓	單面			雙面
解膠溫度	130°C	140°C	150°C	140°C
25μ		<a href="#">TR2512</a>		
100μ	<a href="#">TR1013</a>	<a href="#">TR1012</a>	<a href="#">TR1015</a>	<a href="#">DTA1012</a>